

デバイス実装研究会の開催（3/11）の御案内

主催：アジア半導体機構 共催：公益財団法人九州経済調査協会

新型コロナウイルス感染症のため、2020年から延期をしておりましたが、2年ぶりに会場とオンラインのハイブリッド方式で開催致します。

今回は、4名の方をお招きし、Cu to Cu 接合やチップレットなど、最新の实装技術に関する研究開発ならびにビジネス動向についてお話しいただきます。

年度末のご多忙の折、大変恐縮でございますが、是非、皆さまの事業・研究にお役立て頂きたく、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

会期：2022年**3月11日（金）14:00～17:30**（開場13:30）

会場：電気ビル共創館 3階 カンファレンスA（大会議室）

（〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号）

オンライン：Zoom ウェビナー

アクセス：地下鉄七隈線 渡辺通駅直結、西鉄バス 渡辺通1丁目電気ビル共創館前停より徒歩1分

御申込方法：所属、役職、氏名、ご連絡先、懇親会参加の有無等をご記入の上、

事務局（九経調 HP）イベント掲載ページ（下記 URL）よりお申し込みください。

<https://www.kerc.or.jp/seminar/2022/02/31lastsa.html>

定員：会場：50名（150名収容の大会議室を定員1/3で使用します）

オンライン：100名

※懇親会は20名（先着順：開催時点の感染防止ガイドラインに則って実施可否を検討します）

会費：講演会 1,000円 懇親会 4,000円

備考：講演会参加費は、お申込みの際にクレジット決済でお願いします。懇親会費は、当日、受付にてお支払いください。なお、キャンセルの際に、ご返金できませんのであらかじめご了承ください。

■プログラム■

<講演会>

開会挨拶 14:00～14:05 アジア半導体機構 会長 森下 順（株式会社ウォルツ 代表取締役社長）

基調講演 14:05～14:50 「超精密 CMP 技術の基本とその応用～ボンディングに関わる Cu-CMP への道」
（株）Doi Laboratory 代表取締役 九州大学名誉教授
土肥 俊郎 氏

報告1 14:50～15:35 「チップレット集積技術」
東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 特任教授
栗田 洋一郎 氏

ブレイク

報告2 15:50～16:35 「半導体に向けたレーザー転写技術応用検討」
東レエンジニアリング(株) 開発部門 開発部長
新井 義之 氏

報告3 16:35～16:55 「3次元パッケージング工程におけるウェハボンディングプロセス用 CMP スラリに求められる特性」
昭和電工マテリアルズ(株) 情報通信開発センタ 研磨材料開発部 専任研究員
市毛 康裕 氏

報告4 16:55～17:25 「研磨と接合による高集積 3D 半導体技術の開発動向」
横浜国立大学 大学院工学研究院 システムの創生部門 准教授
井上 史大 氏

閉会挨拶 17:25～17:30 アジア半導体機構 副会長 高木 タッド（台井科技股份有限公司 総経理）

<懇親会> ※講演会が終わり次第、講演会会場近くにて開催いたします。

本年度のデバイス実装研究会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、会場とオンラインのハイブリッド方式にて開催いたします。

尚、会場での聴講をお申し込みいただいた方も、新型コロナウイルス感染状況により、オンラインのみでの開催になる場合がございます。皆様には、大変ご不便をおかけするかとは存じますが、お申込の際は、必ず e-mail アドレスをご記入いただきますようお願い致します。



■お申込方法：九経調ホームページ (<https://www.kerc.or.jp>)

または QR コード よりお申し込みください。

お申込 URL：<https://www.kerc.or.jp/seminar/2022/02/31lastsa.html>

■定員：

会場 50名

オンライン 100名 ※事前登録が必要です

■参加費：講演会 1,000円 懇親会 4,000円

※講演会参加費は、お申込みの際にクレジット決済でお願いします。

※懇親会費は、当日、受付にてお支払いください。

※キャンセルの際に、ご返金できませんのであらかじめご了承願います。

■お申し込み後のご連絡：

会場： ホームページからお申込み後、お申込完了のメールが届きます。定員に達した場合のみご連絡差し上げます。

オンライン： ホームページからお申込み後、参加費お支払いのご案内メールが届きます。参加費のお支払い後に、参加用 URL がついたメールが届きます。

※メールは自動返信ではございません。タイムラグがありますのでご了解ください。

※資料がある場合、開催時間1時間前に登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

■その他：

※1： ネット配信サービス「ZOOM」にてライブ配信致します。事前のアプリインストール（無料）を推奨しますが、それが難しい方は、WEBブラウザ（Google Chrome）からご参加ください。

※2： 安定したWi-Fi環境下でご視聴ください。

※3： 参加者の映像・音声・お名前などは表示されません。

以上

お問い合わせ先：

アジア半導体機構事務局：公益財団法人九州経済調査協会 担当：横寺、相川、岡野

Tel：092-721-4909 E-mail：astsa@kerc.or.jp

住所：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 5F